

MAP 2012

The 12th International Workshop on Microelectronics Assembling and Packaging &SIIQ Marketing Seminar

第2回 新生デバイス実装研究会

MAP2012 Program Overview

2012年10月17日(水)MAP2012&SIIQ Marketing Seminar @電気ビル共創館

10:30~10:35	Opening Remark
10:35 ~ 12:00	Session 1: Invited Talk (SIIQ Marketing Seminar)
12:00 ~ 13:00	Lunch Break
13:00 ~ 14:40	Session 2: International Standardization on Embedded Device Technology
14:40 ~ 15:00	Break
15:00 ~ 16:40	Session 3: Device Embedded Substrate
16:40 ~ 17:00	Break
17:00 ~ 18:00	Session 4: India Session
18:00 ~ 19:25	Reception Party @Esperanza (Kyoso-Kan 1F)

2012年10月18日(木) 第2回 新生デバイス実装研究会@アクア博多

13:00 ~ 14:30	Session 1: アジア最新エレクトロニクス事情
14:30 ~ 15:00	Break
15:00 ~ 17:00	Session 2: 半導体熱解析最新技術

※上記は、2012年9月24日(月)時点のプログラムです。

※最新情報は、九州経済調査協会 (<http://www.kerc.or.jp/>) ホームページ内の MAP2012 特設ページ (<http://www.kerc.or.jp/info/2012/09/astsamap2012.html>) を御覧下さい。

MAP2012 Program (tentative)

Wednesday 17th, October

10:00~10:35 Opening Remark

10:35~12:00 Session 1: Invited Talks(SIIQ Marketing Seminar)

- 10:35-11:15 1-1 Theme adjustment: Memory, Assembling etc.(tentative)
Tomoaki Takubo
Toshiba Corporation, Semiconductor & Storage Product Company (JAPAN)
- 11:20-12:00 1-2 EEE Parts for Space Application
Hiroyuki Shindo
Japan Aerospace Exploration Agency (JAPAN)

12:00 ~ 13:00 Lunch Break

13:00~14:40 Session 2: International Standardization on Embedded Device Technology

- 13:00-13:20 2-1 International Standardization Activities Updated on Embedded Device Technology (tentative)
Hisao Kasuga
Adjustment(JAPAN)
- 13:20-13:40 2-2 EU status updated and Framework of International Standardization (IECTC91WG6) (tentative)
Walter Huck
Adjustment(Adjustment)
- 13:40-14:00 2-3 U.S.A. Status Updated (IPC) (tentative)
Dieter Bergman (or Marc Carter)
Adjustment(Adjustment)
- 14:00-14:20 2-4 Korean Status Updated(tentative)
Hyunho Kim
Adjustment(KOREA)
- 14:20-14:40 2-5 Japan Status Updated(tentative)
Hajime Tomokage
Fukuoka University (JAPAN)

14:40~15:00 Break

15:00~16:40 Session 3: Device Embedded Substrate Technology

- 15:00-15:20 3-1 Standardization on Embedded Passive Device and its Evaluation Method(tentative)
Masashi Aoki
KOA Co., Ltd. (JAPAN)
- 15:20-15:40 3-2 Design of Device Embedded Substrates by CR-8000(tentative)
Kazunari Koga
Zuken Inc. (JAPAN)
- 15:40-16:00 3-3 Application of CADVANCE to Designing Device Embedded Substrates
Hiroshi Matsuoka
YDC Corporation (JAPAN)

- | | | |
|-------------|-----|---|
| 16:00-16:20 | 3-4 | Embedded Passive and Active Devices (EPADs) Consortium of Japan Institute of Electronics Packaging (JIEP) (tentative)
Yoshihisa Katoh
<i>Fukuoka University (JAPAN)</i> |
| 16:20-16:40 | 3-5 | Testing Technology on Embedded Passive and Active Devices Linked with CAD Tools(tentative)
Hiroshi Yamazaki
<i>Hioki E.E. Corporation</i> |

16:40~17:00	Break
--------------------	--------------

17:00~18:00 Session 4: India Session

- | | | |
|-------------|-----|--|
| 17:00-17:20 | 4-1 | EMS business in India (tentative)
Adjustment
<i>Elcoteq Bangalore (INDIA)</i> |
| 17:20-17:40 | 4-2 | Technology Trend of Semiconductor Design in India (tentative)
Adjustment
<i>Silicon Interfaces Pvt. Ltd. (INDIA)</i> |
| 17:40-18:00 | 4-3 | Semiconductor for Business Intelligence (tentative)
Adjustment
<i>Persistent Systems Limited (INDIA)</i> |

18:00~19:25 Reception Party @Esperanza (Kyoso-Kan 1F)

第2回 新生デバイス実装研究会プログラム

Thursday 18th, October

13:00-14:30 Session 1: アジア最新エレクトロニクス事情

- | | | |
|-------------|-----|---|
| 13:00-13:45 | 1-1 | インドエレクトロニクス産業現地調査報告
平田 エマ
財団法人九州経済調査協会 |
| 13:45-14:30 | 1-2 | ベトナムエレクトロニクス産業現地調査報告
中川 敬基
財団法人九州経済調査協会 |

14:30~15:00	Break
--------------------	--------------

15:00-17:00 Session 2 半導体熱解析最新技術

- | | | |
|-------------|-----|---------------------------------|
| 15:00-16:00 | 2-1 | 半導体熱応力解析技術(仮題)
三浦 英生
東北大学 |
| 16:00-17:00 | 2-2 | パッケージ応力解析(仮題)
宮崎 則幸
京都大学 |

申込方法

① MAP2012 に参加される方

- ・ 参加費用は、15,000 円です。
- ・ 御申込用紙に必要事項を記入の上、アジア半導体機構事務局（担当：庄村）、FAX(092-721-4904)もしくは E-mail(shomura@kerc.or.jp)までお送り下さい。
- ・ 折り返し、ご請求書をお送りします。
- ・ 午前の部のみご参加の方は、無料です。
- ・ なお、MAP2012 午後の部にご参加の方は、第 2 回新生デバイス実装研究会に無料でご参加頂けます。

② 第 2 回 新生デバイス実装研究会のみ参加される方

- ・ 参加費は、500 円です。
- ・ 御申込用紙に必要事項を記入の上、アジア半導体機構事務局（担当：庄村）、FAX(092-721-4904)もしくは E-mail(shomura@kerc.or.jp)までお送り下さい。またデバイス実装研究会事務局（担当：佐藤）まで E-mail (satty@fukuoka-u.ac.jp) でお申込頂いても結構です。
- ・ 参加費用は、当日、受付にてお支払いください
- ・ なお、研究会後の懇親会はありませんので、前日の MAP2012 懇親会に是非ご参加ください。

申込用紙

氏名

会社名

部署・役職

住所 〒

E-mail

電話

Fax

御参加頂く内容にチェックをお願い致します。

内容(日時)	参加	参加費
MAP2012 Invited Talk(10/17 AM) ※SIIQ Marketing Seminar	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加	無料
MAP2012 Session 2~Session 4(10/17 AM)	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加	15,000 円
MAP2012 レセプションパーティー&新生デバイス実装研究会前夜祭(10/17 夕方) ※1	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加	※2
新生デバイス実装研究会(10/18PM)	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加	500 円※3

※1 新生デバイス実装研究会後の懇親会はありません。是非、MAP2012 レセプションパーティーにご参加ください。

※2 MAP2012 午後の部にご参加頂いた方は、参加費無料で、レセプションパーティーにご参加頂けます。レセプションパーティー&新生デバイス実装研究会前夜祭に単独でご参加の方は、当日受付で 5,000 円をお支払いください。

※3 MAP2012 午後の部にもご参加頂いた方は、新生デバイス実装研究会の参加費は無料になります。

下記までお送り下さい。

アジア半導体機構(ASTSA) 担当:庄村、中川 Fax: 092-721-4904 E-mail: shomura@kerc.or.jp

※第 2 回デバイス実装研究会のみご参加の方は、下記にメールでお送り頂いても結構です。

福岡大学 友景研究室 秘書:佐藤 E-mail: satty@fukuoka-u.ac.jp

---開催場所にご注意下さい---

MAP2012&SIIQ Marketing Seminar

会期:2012年10月17日(水) 10:30~18:00

会場:電気ビル共創館 カンファレンス C

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 5F

アクセス:福岡市市営地下鉄 渡辺通駅 直結

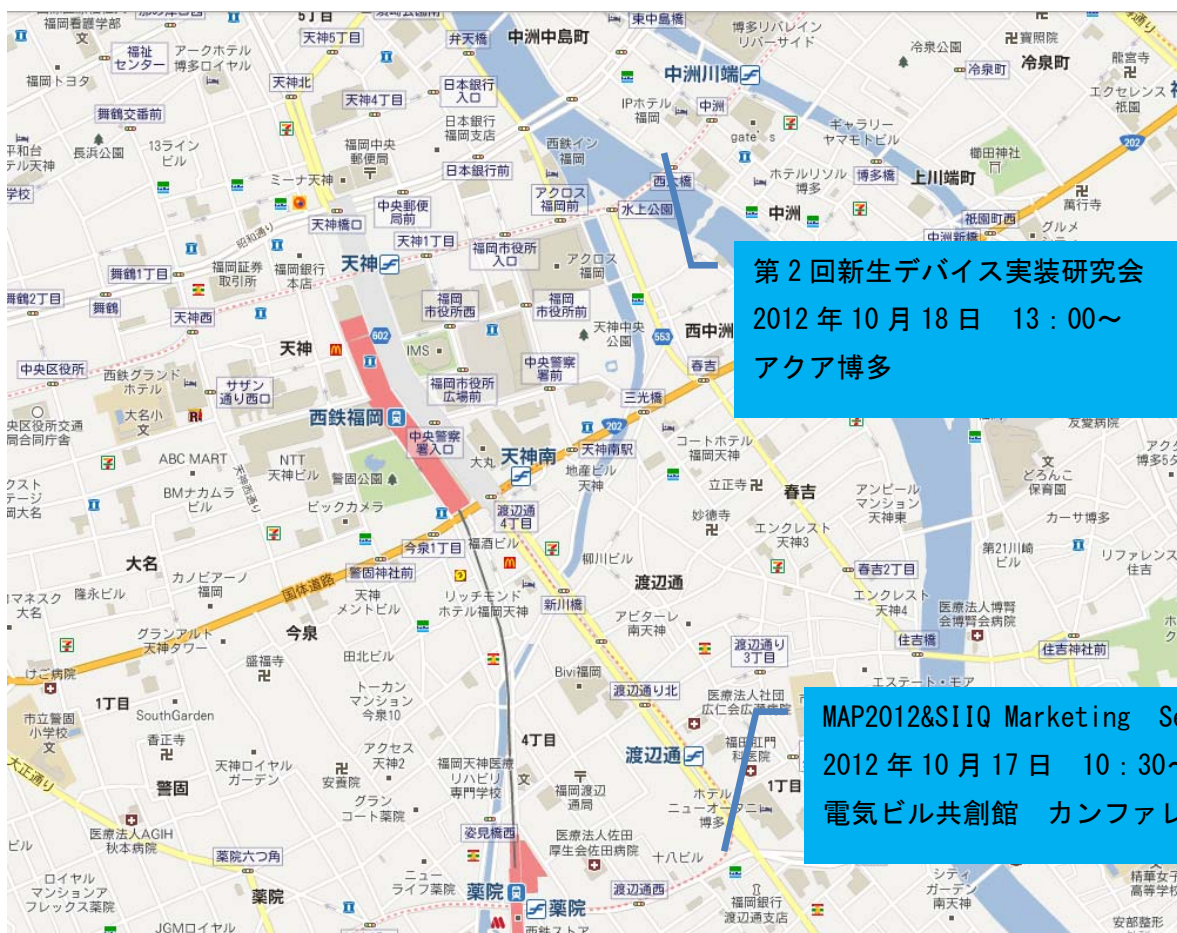
第2回 新生デバイス実装研究会

会期:2012年10月18日(木) 13:00~17:00

会場:アクア博多

〒810-0801 福岡市博多区中洲 5-3-8

アクセス:福岡市市営地下鉄 中洲川端駅 徒歩5分



Google Map

---お問い合わせ先---

MAP2012&SIIQ Marketing Seminar

MAP2012 実行委員会事務局(財団法人九州経済調査協会内)

担当:中川、庄村

Tel:092-721-4907 Fax:092-721-4904

E-mail:shomura@kerc.or.jp

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 5F